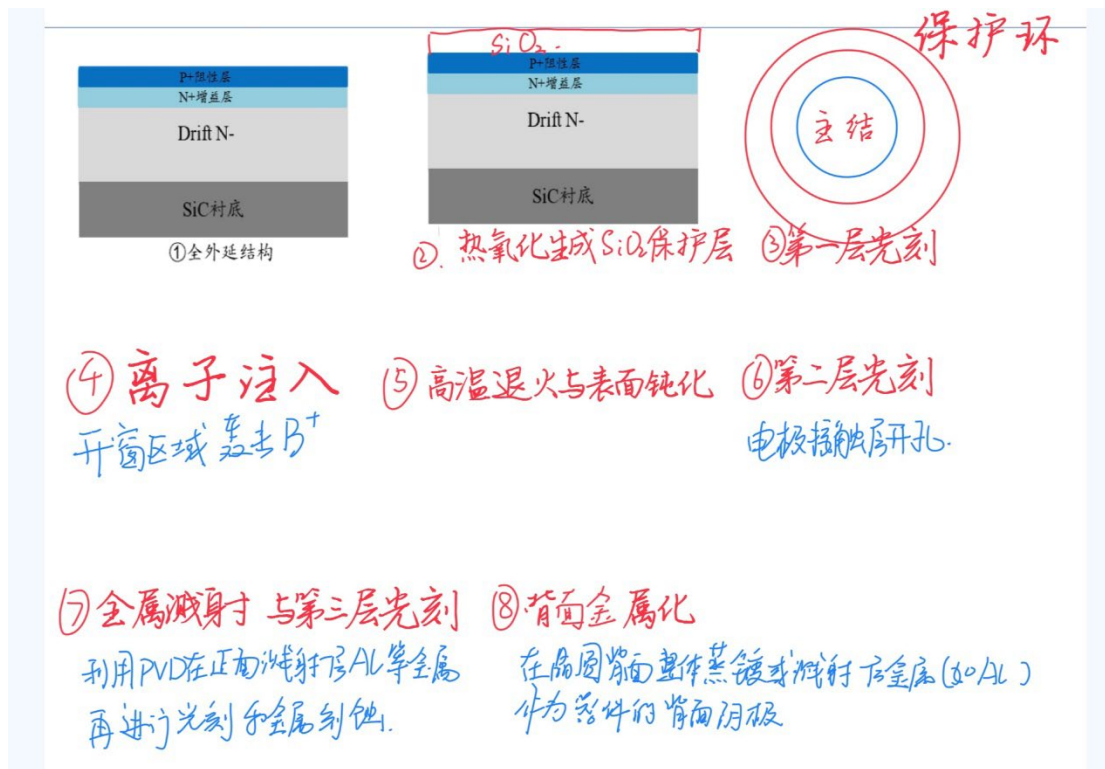
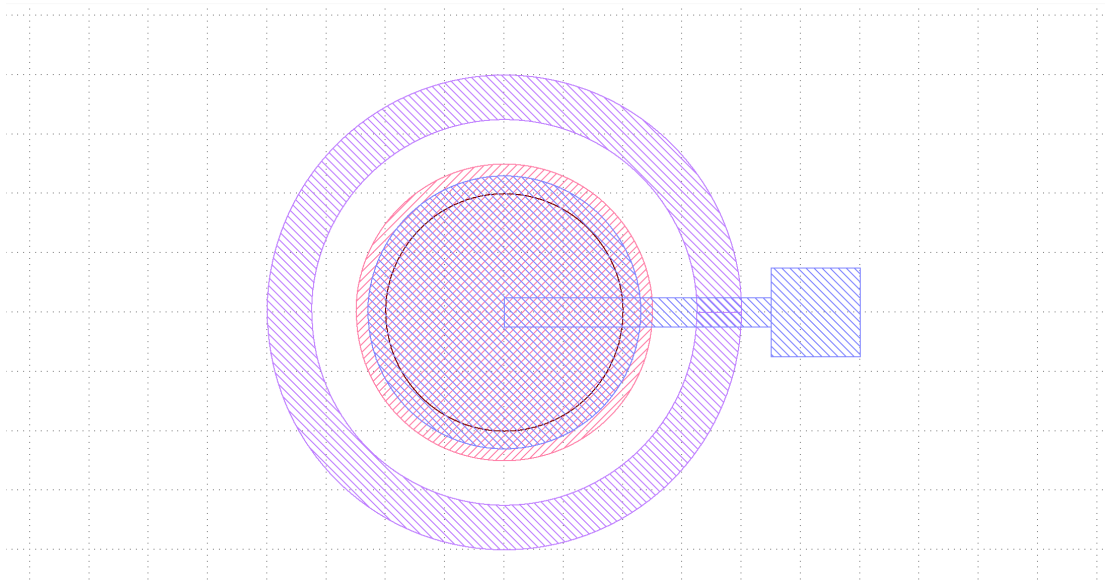


## 1. 保护环终端的器件流程图；



## 2. 刻蚀终端器件的光刻板；



**Layer1 (红色线框圆):** P+注入层, 定义了器件中心的圆形主结区。

**Layer2 (紫色外环):** 终端刻蚀槽层, 完美地包裹在主结外围, 用于刻蚀去除表层硅材料。

**Layer3 (深蓝色内圆):** 钝化层开孔 (Contact), 尺寸小于 P+注入区, 确保后续金属只能接触到 P+区, 不会发生边缘短路。

**Layer4 (浅蓝色斜纹):** 金属层, 包含覆盖主结的圆形电极 (半径略大于接触孔形成场板)、右侧的测试 PAD 方块, 以及连接两者的金属桥。